

Глобал Инжиниринг



**ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ**



все ремонтные станции
на сайте GLOBAL-SMT.RU

РЕМОНТ ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ

Комплексные решения для ремонта печатных плат — необходимы там, где требуется качественное обслуживание изделий с высокой плотностью монтажа. Системы с открытой модульной архитектурой, укомплектованные видеосистемами для демонтажа и точной установки BGA-микросхем, способны обеспечить полный технологический цикл ремонта на одной платформе.

В нашем каталоге представлены системы для производственных площадок любого уровня — от опытного и мелкосерийного производства до линий крупносерийного массового выпуска радиотехнической продукции.



FINEPLACER core^{plus} | FINETECH

универсальный ремонтный центр



расширенное описание
и характеристики модели
на сайте GLOBAL-SMT



Универсальный центр FINEPLACER core plus предназначен монтажа-демонтажа с контролируемым усилием компонентов от 01005 до сложных микросхем в корпусах BGA, QFP, QFN, MLF. с габаритами до 50x50 мм.

ОСОБЕННОСТИ

- полностью конвекционный нагрев
- нижний нагреватель имеет изменяемую геометрию
- интеллектуальное управление нагревателями
- оптическая система совмещения на основе призмы
- камера наблюдения за процессами пайки в реальном времени
- автоматическая калибровка
- прецизионный ручной подъём модуля пайки

ПРОЦЕССЫ

- демонтаж компонентов
- удаление остатков припоя
- восстановление шариковых выводов компонентов BGA (реболлинг)
- трафаретная печать пасты на компоненты и платы
- нанесение паяльной пасты на компоненты окунанием
- дозирование паяльной пасты
- флюсование и пайка

МОДУЛИ

- модуль прямой трафаретной печати на компонент
- модуль реболлинга
- модуль флюсования
- SmartIdent — снятие штрих-кодов
- SmartControl — сенсорное управление
- модуль переключения на азот
- модуль бесконтактного удаления припоя
- печь MiniOven 04

ПРЕИМУЩЕСТВА

- равномерный и воспроизводимый нагрев
- автоматическое выполнение процесса без участия оператора
- полный цикл ремонта в одном центре
- воспроизводимая точность позиционирования
- координированный контроль параметров процесса
- быстрый выход на рабочий режим
- безопасная работа с хрупкими компонентами

ПРИЛОЖЕНИЯ

- пайка и ремонт:
 - BGA, μ BGA/CSP, QFN, DFN, PoP, QFP, PGA...
 - пассивных компонентов до 01005
 - защитных экранов и рамок
 - разъёмов, контактов, субмодулей
- технология пайки «Pin in Paste» (PiP)
- технология пайки «Through Hole Reflow» (THR)
- компоненты залитые компаундом

ОПЦИИ

- насадки трафаретной печати на плату
- ИК-датчик температуры/старт-сенсор
- система визуального совмещения и фокусирования сложных микросхем
- держатель компонентов
- камера кругового наблюдения за процессом
- оптическая система с 10-кратным увеличением
- нагреватель HOTBEAM

Размеры печатной платы, мм	400x310 (max)
Точность, мкм	25
Поле зрения (минимально), мм	12,1x7,6
Поле зрения (максимально), мм	65,0x45,0
Размер компонента (минимально), мм	0,125x0,125
Размер компонента (максимально), мм	70,0x70,0
Мощность верхнего нагревателя, Вт	900
Мощность нижнего нагревателя, Вт	1600
Оптическая система	6x или 10x



расширенное описание
и характеристики модели
на сайте GLOBAL-SMT

PRO-650 | 1CLICK SMT

конвекционный ремонтный центр

Самый популярный бюджетный ремонтный центр с сенсорным управлением. Он имеет 3 отдельных зоны нагрева и 6 нижних нагревателей с регулируемой высотой, программируемым верхним / нижним нагревом, камерой с 50-кратным увеличением и высоким разрешением, 3 термопарами для профилирования в реальном времени.

Оптическая система визуального выравнивания с CCD камерой высокого разрешения для точной настройки обеспечивает простое, быстрое и точное выравнивание между чипами BGA и печатными платами с точностью выравнивания в пределах 0,01–0,02 мм. Задание профиля осуществляется с помощью сенсорного экрана. Вы также можете перенести свои уже имеющиеся термопрофили с помощью CSV файла.

ОСОБЕННОСТИ

- высокоточная система оптического совмещения
- мощные нагреватели с обеих сторон для работы с бессвинцовыми сплавами и многослойными платами
- термопары крепятся непосредственно к плате, что позволяет точно соблюдать заданный профиль
- автоматическое отключение в случае нештатной ситуации и перегрева
- информирование оператора о завершении процесса монтажа/демонтажа компонента

Минимальный размер плат, мм	8×8
-----------------------------	-----

Максимальный размер плат, мм	380×380
------------------------------	---------

Диапазон компонентов, мм	от 2×2 до 55×55
--------------------------	-----------------

Минимальный шаг выводов микросхем, мм	0,3
---------------------------------------	-----

ZM-R730 | SEAMARK

полуавтоматический ремонтный центр BGA для плат большого размера



расширенное описание
и характеристики модели
на сайте GLOBAL-SMT

Полуавтоматический BGA-станок с видеоцентровкой предназначенный для демонтажа и монтажа BGA, CSP, QFN-микросхем. Оборудование подходит для ремонта материнских плат, видеокарт, ноутбуков и других крупногабаритных печатных плат. Обеспечивает точную пайку и выпайку BGA, CSP, QFN-микросхем, подходит для ремонта крупногабаритных печатных плат. Идеальное решение для ремонтных сервисов электроники, обеспечивающее профессиональный BGA-ремонт с высокой точностью позиционирования.

Для управления ремонтным центром используется управляющий ПК (вкл. ПО производителя), клавиатура, компьютерная мышь. Система технического зрения станции использует 15-дюймовый монитор.

ОСОБЕННОСТИ

- 2 монитора – под управляющий ПК и для системы видеоцентрирования
- камера с системой цифрового изображения и оптическим увеличением
- 8 сегментная настройка температуры нагрева и охлаждения
- загрузка данных через порт USB2.0
- верхний, нижний ИК-нагреватель с трубкой из углеродного волокна
- система фиксации платы - ручная регулируемая оснастка
- возможность интеграции с ERP/MES системами

Минимальный размер плат, мм	6×6
-----------------------------	-----

Максимальный размер плат, мм	635×520
------------------------------	---------

Диапазон компонентов, мм	3×3 — 80×80
--------------------------	-------------

Минимальный шаг выводов микросхем, мм	0,15
---------------------------------------	------



Глобал Инжиниринг

127566, Россия, Москва — Высоковольтный проезд., 1/49
197342, Россия, Санкт-Петербург — Наб. Чёрной речки, 47

Телефон/факс: +7 495 980 0819
e-mail: info@global-smt.ru www.global-smt.ru

